

平成26年10月29日判決言渡

平成26年(ネ)第10040号 職務発明補償金請求控訴事件

(原審 東京地方裁判所平成22年(ワ)第39625号)

口頭弁論終結日 平成26年9月1日

判 決

一 審 原 告 X

(控訴人兼被控訴人)

訴訟代理人弁護士 矢 島 邦 茂

一 審 被 告 沖 電 気 工 業 株 式 会 社

(控訴人兼被控訴人)

訴訟代理人弁護士 永 島 孝 明
安 國 忠 彦
明 石 幸 二 郎
朝 吹 英 太
安 友 雄 一 郎

主 文

- 1 一審原告の控訴に基づいて原判決を次のとおり変更する。
 - (1) 一審被告は、一審原告に対し、50万6000円及びこれに対する平成22年10月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 - (2) 一審原告のその余の請求を棄却する。
- 2 一審被告の控訴を棄却する。

- 3 訴訟費用は、第1, 2審を通じて、これを100分し、その99を一审原告の、その余を一审被告の各負担とする。
- 4 本判決主文第1項(1)は、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

1 一审原告

- (1) 原判決中一审原告敗訴部分を取り消す。
- (2) 一审被告は、一审原告に対し、4970万3601円（原判決認容額と併せて5000万円）及びこれに対する平成22年10月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- (3) 訴訟費用は、第1, 2審とも、一审被告の負担とする。
- (4) 第(2)項につき仮執行宣言。

2 一审被告

- (1) 原判決中一审被告敗訴部分を取り消す。
- (2) 上記取消部分に係る一审原告の請求を棄却する。
- (3) 訴訟費用は、第1, 2審とも、一审原告の負担とする。

第2 事案の概要

用語の略称及び略称の意味は、本判決で付するもののほか、原判決に従う。

1 事案の要旨

(1) 本件請求の要旨

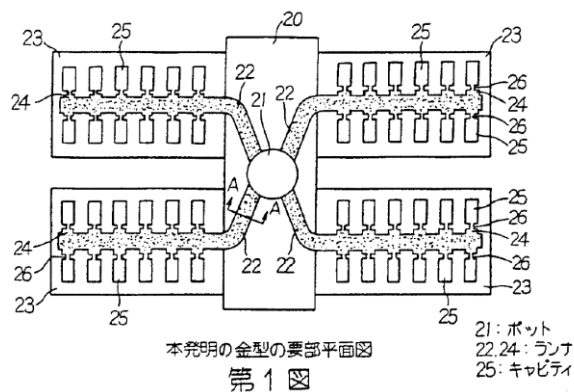
本件は、一审被告の従業者であった一审原告が、一审被告に対し、職務発明である下記樹脂封止金型に係る発明（本件発明）について特許を受ける権利を一审被告に承継させたことにつき、平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項（以下、特許法35条3項及び同4項については、同改正前のものをいう。）に基

づき、相当対価 6 7 億 3 8 4 6 万 1 9 7 5 円の内金 5 0 0 0 万円及びこれに対する本件訴状送達により催告をした日の翌日（平成 2 2 年 1 0 月 2 8 日）から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

本件発明は、本件特許に係る特許公報（甲 6 5）の特許請求の範囲の請求項 1 と同じであり、その内容は、次のとおりである。

「被樹脂封止装置を収容する複数個のキャビティと、前記被樹脂封止装置を封止するための熔融樹脂を貯蔵するポットと、前記ポットから前記キャビティへ前記熔融樹脂を導入するランナとを、有する樹脂封止金型において、前記ランナを構成する金型の内壁面を粗面状に形成したことを特徴とする樹脂封止金型。」

なお、本件公報（公開特許公報）の第 1 図（補正後）を掲記する。



(2) 原審の判断

原判決は、一審被告が一審原告に対して相当対価 4 5 万 9 3 9 9 円から既払金 1 6 万 3 0 0 0 円を控除した未払相当対価 2 9 万 6 3 9 9 円及びこれに対する平成 2 2 年 1 0 月 2 8 日から支払済みまで年 5 分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で本件請求を認容し、その余の請求を棄却した。

これを不服として、一審原告及び一審被告の双方が控訴をした。

2 前提となる事実

本件の前提となる事実は、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2，1に記載のとおりである。

(1) 原判決2頁22行目の「樹脂封止金型に関する発明」を「後記本件特許に係る特許公報（甲65）の特許請求の範囲の請求項1のとおり樹脂封止金型に関する発明」に改める。

(2) 原判決3頁10行目から12行目までを次のとおり改める。

「前記特許出願の願書に添付した明細書及び図面（以下「本件明細書」という。）の記載は、原判決添付の公開特許公報（甲1の2）のとおりであり（ただし、平成元年11月30日付け手続補正書〔甲1の3〕による補正により第1図等が補正されている。），本件発明の内容は、本件特許に係る特許公報（甲65）の特許請求の範囲の請求項1と同じであり（同公報の明細書及び図面は、上記補正後の本件明細書と実質的に同一である。），その内容は、次のとおりである。

『被樹脂封止装置を収容する複数のキャビティと、前記被樹脂封止装置を封止するための溶融樹脂を貯蔵するポットと、前記ポットから前記キャビティへ前記溶融樹脂を導入するランナとを、有する樹脂封止金型において、前記ランナを構成する金型の内壁面を粗面状に形成したことを特徴とする樹脂封止金型。』

(3) 原判決添付の公開特許公報（本件公報）の末尾に本判決別紙を加える。

3 本件の争点は、原判決の「事実及び理由」欄の第2，2に記載のとおりである。

第3 争点についての当事者の主張

争点についての当事者の主張は、下記１・２に当事者の当審における補充主張をそれぞれ加えるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第２，３に記載のとおりである。

１ 一審原告の当審における補充主張

(1) 売上高

一審被告の関連会社である宮崎沖電気工業株式会社、宮城沖電気株式会社及びオキ・タイランドCo., Ltd.（以下「関連会社」という。）は、一審被告との連結決算の対象会社であり、一審被告の事業部門に相当するなど一審被告と密接な関係にあるほか、一審被告はこれらの関連会社から本件発明の技術的範囲に属する金型の使用について実施料を徴収していない。

そうすると、これら関連会社の半導体製品の売上高も、一審被告自身の売上高と同視するべきである。

(2) 自己実施割合

昭和６０年代を代表する半導体製品（半導体パッケージ）であるDIP(Dual In-line Package)は、半導体装置の小型化、薄型化が求められて半導体製品の基板設置方法が表面実装方式に変革していくなかで、順次製造されなくなっていった。また、長期稼働、大量生産による損耗などにより寿命が尽きた金型は廃棄されるであろうし、仮に寿命が尽きていなかったとしても、本件発明の技術的範囲に属する半導体樹脂封止金型の優位性が証明されれば、本件発明の技術的範囲に属する半導体樹脂封止金型だけが使用されるようになる。そうすると、当初存した金型がその後も継続して使用され続けることはあり得ないから、本件発明の技術的範囲に属する金型の全金型における使用割合を求めるに当たっては、過去に存した金型の中から、上記のような理由から廃棄された金型数を控除する必要がある。

ところで、金型の平均寿命は、成形に使用される樹脂の種類（成分）で異なるものの、およそ３年程度と推測される（甲６３の１～３）。また、仕様書作成年月日を平成６年１０月３日以降とする金型は、すべて、ランナ部を梨地状に形成している。

そうすると、少なくとも平成9年以降は、一審被告にて使用していたすべての金型のランナ部が梨地状に形成されたもの、すなわち、本件発明の技術的範囲に属する金型であるといえる。

(3) 技術的優位性

本件発明の技術的優位性は、ランナ部を梨地状に形成したことのほかに、ランナの断面形状を台形状（開口部側を広く加工する）に形成した点にもある（甲1の2の第4図）。そして、この特徴は従来技術にはなく、また、先行技術とする乙22の1・2の刊行物にも開示されていない。そうすると、この点において、本件発明には技術的優位性がある。

(4) 訴訟手続違反

一審原告は、本件請求について、①半導体製品の売上高に基づき導き出す方法と②一審被告の「特許報奨制度に定める実施貢献評価の算出方法」に基づき導き出す方法の両者を、請求原因事実として主張している。したがって、上記①によって認定された金額が、同②によって導き出されると一審原告が主張する金額と異なるという理由だけでは、同②の主張が認容されないことにはならない。それにもかかわらず、原判決は、その旨の理由で同②の主張を排斥した。そうすると、原審は、同②の主張について実質的に審理をしていない。したがって、原審の訴訟手続には違法がある。

2 一審被告の当審における補充主張

(1) 自己実施

マルチポット方式による半導体樹脂封止金型は、「各ポットに投入された封止用樹脂を、ランナを介さないで直接ゲートを介して各キャビティに溶融圧入させる方式の成形金型」であり、「ゲート部」と称され、ポットからキャビティまでの経路が短く、経路の断面積が狭まる圧入部分を有するだけである。したがって、マルチポット方式には、シングルポット方式に存する「ランナ部」が存在し得ず、本件発明が

実施されることはあり得ない。

(2) 公然実施

乙12の1～3は、いずれも、本件特許出願前に作成されたマルチポット方式の金型の製作仕様書である。これらの製作仕様書と、一審原告が本件発明が実施されているとする甲18の1～7の各製作仕様書とを対比すると、両者は、全く同様のマルチポット方式の金型の製作仕様書である。したがって、一審被告は、本件特許出願の前後を通じて上記金型を使用していたのであるから、本件発明に新規性があるとすれば、それは、上記金型を除く種類の金型についてのものでなければならない。

(3) 売上高

本件発明は、半導体製品に関するものではなく、半導体装置の製作に係る樹脂封止金型に関する発明であるから、本件発明の技術的範囲に含まれる樹脂封止金型を使用して半導体装置を製造したとしても、それら半導体装置は、本件発明の実施品には該当しない。そうすると、半導体装置の譲渡による売上高は、本件発明の実施により生じる利益とは法的には無関係であり、半導体装置の売上高を相当対価の判断の基礎とすることはできない。

第4 当裁判所の判断

当裁判所は、一審原告の請求は、50万6000円及びこれに対する本件訴状送達により催告のあった日の翌日である平成22年10月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないものと判断する。

その理由は、下記1のとおりに原判決を補正し、下記2のとおりに補充の判断を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第3に記載されたとおりである。

1 原判決の補正

(1) 原判決16頁8行目から同12行目までを次のとおり改める。

「証拠（甲 6 5）によれば、本件発明は、『被樹脂封止装置を収容する複数のキャビティと、前記被樹脂封止装置を封止するための溶融樹脂を貯蔵するポットと、前記ポットから前記キャビティへ前記溶融樹脂を導入するランナとを、有する樹脂封止金型において、前記ランナを構成する金型の内壁面を粗面状に形成したことを特徴とする樹脂封止金型。』という構成であることが認められる。」

(2) 原判決 1 9 頁 1 9 行目から同 2 1 頁 5 行目までを次のとおり改める。

「(ア) 争いのない事実と証拠（甲 3 の 2・3, 6, 1 7 の 1～2 の 4, 1 8 の 1～7, 3 0 の 2, 3 9 の 1～3, 4 1 の 2, 4 2 の 1・2, 4 8 の 2, 4 9 の 3, 5 2 の 2～4, 5 3, 5 6 の 1～3, 5 9, 乙 8, 1 2 の 1～3, 1 3）及び弁論の全趣旨により認められる事実は、次のとおりである。

① 一審被告とその連結子会社である関連会社は、金型製作メーカーの TOWA 株式会社（以下「TOWA」という。）に対し、半導体装置用の金型を製作させ、これを用いて半導体装置の製造をしていたところ、本件発明がされた昭和 6 0 年から本件特許権が消滅した平成 1 7 年までの間に TOWA が製作した金型の台数は、本判決別表 1 のとおり、9 4 台である（同別表の「客先番号」欄に「CO」又は「ACO」とあるのは一審被告を、同「JC」又は「AJC」とあるのは宮崎沖電気株式会社を、同「JJ」とあるのは宮城沖電気株式会社を、同「AT」とあるのはオキ・タイランド Co., Ltd. をそれぞれ示す。）。

② 上記①の 9 4 台の金型は、いずれも、樹脂封止されるチップやリードフレームを収容する複数のキャビティと、当該キャビティに樹脂を注入するための入口の前までの流路と複数のポットとを有するマルチポット方式を採用していた。

③ 仕様書作成年月日を平成 4 年 7 月 2 日とする 4 台の金型と仕様書作成年月日を平成 6 年 1 0 月 3 日以降とする 2 5 台の合計 2 9 台の金型は、

いずれも、上記流路における樹脂に接する内壁面を表面粗さが約5～16 μmRz の梨地状に形成したものであり、本件発明の「ランナ」「粗面状」の意味に照らし、本件発明の技術的範囲に属するものであった。

- ④ 一審原告が平成12年11月18日に一審被告から授与された実施評価優秀賞は、本件発明が成果顕著なものであったという理由で授与されたものであり、一審原告が同月20日に支給された1等級の貢献特許報奨金15万円（Aも同額）は、同報奨金の算定方式上、一審被告の過去3年間の販売実績のうち、本件発明が貢献した部分を換算した額が、少なくとも1億円以上であると評価されないと受給し得ないものであった。」

- (3) 原判決22頁1行目の「自らが」から同7行目の「について、」までを削る。

- (4) 原判決22頁21行目の「証拠」から同23頁3行目の「限らない。」までを次のとおり改める。

「証拠（甲19、25、26の1～4、乙14、15、19、24、25）によれば、複数個のポットを有するマルチポット方式の樹脂封止金型であっても、ポットからキャビティまでの間に樹脂を送るための流路を必要とするのであり、これが、キャビティ入口部のゲートとしての機能を兼ねることも可能であるから、たとえ当該部分を本来的なゲート部と共に『ゲート部』と総称することがあるとしても、本件発明の『ランナ』が経路の長短を問わないものである以上、上記流路は、本件発明の『ランナ』を含むといえる。」

- (5) 原判決24頁4行目の「TOWAからの提案を受け、」を削る。

- (6) 原判決24頁12行目から同31頁15行目までを次のとおり改める。

「(ア) 一審被告の自己実施による売上高について

a 本件発明と関連する売上高割合

(a) 本件発明の実施と一審被告が受けた利益

前記(2)イにて認定した事実によれば、一審被告は、本件発明をTOWAをして実施させ、これにより製作された樹脂封止金型を用いて半導体装置を製造することにより、半導体装置製造の歩留りが向上し、製造コストを低下させることにより利益を得たものといえる。そして、これは、一審被告の自己実施により一審被告に生じた利益と同視できる。

また、一審被告は、本件発明を関連会社を通じてTOWAをして実施させ、関連会社において、これにより製作された樹脂封止金型を用いた半導体製造装置を製造することにより、関連会社において、半導体装置製造の歩留りが向上し、製造コストを低下させることにより利益を得たものといえる。そして、関連会社が一審被告に対して本件発明の実施に係る実施料を支払ったとは認められないから、この関連会社に生じた利益は、連結決算関係を通じて、一審被告に帰属していると評価できる。そして、この関係は、一審被告の自己実施により一審被告に生じた利益と同視できる。

そして、本件証拠上は、一審被告が製作させた金型の総数・種類や、半導体装置の売上高と一審被告の決算書における売上高との対応関係は必ずしも分明ではないが、本件審理の経過等の諸般の事情にかんがみると、一審被告の「電子デバイス」に係る連結決算売上高に、基準として、TOWA製作に係る半導体樹脂封止金型における本件発明の技術的範囲に属する半導体樹脂封止金型の数が占める割合を乗じたものをもって、一審被告が本件発明の実施により製造した半導体装置の売上高とし、相当対価の算定の基礎とすることが相当である。

(b) 本件発明の技術的範囲に属する金型の割合

争いのない事実と前記(2)イ(ア)に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、TOWA作成に係る半導体樹脂封止金型（光沢）と本件発明の

技術的範囲に属する半導体樹脂封止金型（梨地）の台数は、本判決別表 1 の「台数」「流路壁面の状態」欄に記載されたとおりである。

ところで、金型は、製品の変更に伴い使用されなくなるものであるほか、使用に伴う損耗に伴って一定期間経過後に使用できなくなるとは明らかであるが、本判決別表 1 に記載された各金型が、どの程度の期間使用されたかを直接に明らかにするに足りる証拠はない。

しかしながら、一般的に金型の使用可能回数の目安が 10 万ショットとされること（甲 63 の 3）を考慮すると、製品の変更がないとしても、ある特定の金型が 5 年を超えて使用される可能性は極めて低いものと推認される。そうすると、過去 5 年分の金型を取り上げて、その中での本件発明の技術的範囲に属する金型の割合を算定することをもって、上記のような直接的な使用期間の認定に代えることが相当というべきである。

そこで、検討すると、その割合は、本判決別表 2 ～ 9 に記載のとおり、次のとおりとなる。

平成 5 年 3 月末	4 / 4 5
平成 6 年 3 月末	4 / 4 1
平成 7 年 3 月末	6 / 3 2
平成 8 年 3 月末	8 / 2 3
平成 9 年 3 月末	1 0 / 2 4
平成 1 0 年 3 月末	7 / 1 2
平成 1 1 年 3 月末	1 1 / 1 2
平成 1 2 年 3 月末以降	全部

(c) 本件発明の実施期間

本件発明が実施されていた期間は、TOWA に対して本件発明の技術的範囲に属する半導体樹脂封止金型に係る仕様書を初めて作成させ

た平成4年7月2日に、金型の製作期間を見込んで、約2か月を加えた同年9月1日から、その日の経過により本件特許権が消滅する日である平成17年12月16日までと認めるのが相当である。

(d) 全売上高

証拠（甲29の6～19，30の2，41の2）によれば、一審被告と関連会社の「電子デバイス」の売上高は、次のとおりである（いずれも、「平成4年度」の場合は、平成4年4月から翌平成5年3月までを示すように表記されている。）

平成4年度	約1508億7000万円
平成5年度	約1723億9400万円
平成6年度	約1873億1100万円
平成7年度	約2141億2600万円
平成8年度	約1313億3800万円
平成9年度	約1350億2400万円
平成10年度	約1167億4100万円
平成11年度	約1591億7800万円
平成12年度	約1819億0000万円
平成13年度	約1136億0000万円
平成14年度	約1192億0000万円
平成15年度	約1322億0000万円
平成16年度	約1507億0000万円
平成17年度	約1507億0000万円

(e) 算定

以上の検討結果に基づくと、本件発明を実施して製造された半導体装置の売上高は、本判決別表10の1（関連売上高）に記載のとおり、合計1兆3384億5808万円（1万円未満切り捨て）となる。

b 本件発明の寄与度

本件発明は、半導体装置を封止する樹脂の成形不良を減少させるとする効果を有する発明であり、半導体装置の製造コストを低下させるものであり、実際にも、成果顕著なものであったという理由で、一審被告から実施評価優秀賞を授与されている（甲 6， 17 の 1）。

しかしながら、半導体装置の機能は、演算処理をして所定の動作をすることにあり、この機能を有するのは、専ら半導体装置中のチップ部である。したがって、半導体装置を購入する際の動機の形成に専ら寄与しているのは、チップの性能、用途等であって、樹脂から成型されるパッケージそれ自体が、半導体装置の購入に当たって着目されているとはいえない。また、歩留まり向上によるコスト削減によって価格を低下又は維持させても、半導体装置の機能を代替できるものではないから、コスト削減の売上高に対する寄与は、一面的なものに限定される。

そして、半導体装置の製造に当たり、その手間と費用が精密なチップに集中することは明らかであるが、チップ等を封止するパッケージの機能は、チップを外気から遮断して保護することにあり（甲 3 2），半導体装置の中では補助的な部材にすぎず、この点に手間と費用が集中しているとは認め難い。したがって、半導体装置の歩留りに影響する主たる要素は、樹脂封止以外の点にあるものと認められる（甲 3 3， 3 4）。

そして、本件発明は、前記(2)ア(ウ)のとおり、樹脂封止金型において、樹脂に摩擦抵抗を与え、渦流を発生させて温度分布を一様にし、樹脂のキャビティへの移送を円滑にするとともに、波の発生を抑えて空気の巻き込みを軽減したり、樹脂中に混入している気泡を移送中に付着吸収したりし、気泡のキャビティへの流入を軽減させる効果を有するにとどまり、樹脂のキャビティへの移送を確実に行わせたり、気泡のキャビティへの流入を完全になくす効果を有するものではない。一方で、樹脂封止

における歩留りの改善のためには、前記のマルチポット方式を採用することのほかに、熔融樹脂の改良や管理の強化、流動状態の均一化などの製造方法の改善などが様々な対策が現に図られており（乙 9，10），歩留りの向上は、これら総合的な対策の効果により生じるものであり、樹脂封止の点の改善による効果は限定的であるといえる。

これらの事情を総合すれば、本件発明の自己実施が半導体装置製造についてそのコスト削減に寄与するものであるとしても、一審被告が上記 a 所定の売上高を得るに当たって本件発明が果たした寄与は、0.1%であると認めるのが相当である。

そうすると、一審被告が本件発明から得た利益を算定する上での基準となる売上高は、本判決別表 10 の 2（発明の寄与度）のとおり、13 億 3845 万円（1 万円未満切捨て）と認められる。

c 超過売上高

製造コストの低下した製品に他社を排除する効果があることは明らかである。

しかしながら、①証拠（甲 25，26 の 1～4，30 の 2，43，49 の 3，乙 15，19，25）及び弁論の全趣旨によれば、昭和 54 年ころから、ポットを複数個にして樹脂の移送距離を短くしたマルチポット方式の半導体樹脂封止金型が使用され始め、この方法が歩留りを改善するものであったこと、②証拠（乙 22 の 1・2）によれば、昭和 58 年ころには、従来技術として、被樹脂封止装置を収容する複数個のキャビティと、該キャビティに樹脂を導入するランナ及びポット（1 個）とを有する樹脂封止金型において、前記キャビティの側面のみを鏡面加工し、その底面及び前記ランナにおける前記樹脂に接する壁面を EDM 法で形成した（壁面が梨地状になる。）樹脂封止金型が用いられていたことが認められ、TOWA も、平成 5 年ころから、一審被告以外の顧客に対

しても、ランナ等における樹脂に接する壁面をEDM法で形成したマルチポット方式の半導体樹脂封止金型を製作するようになっていたことが認められる。したがって、本件発明の実施は、製造コスト低減に関して、他の技術に比して、高い優位性や強い独占の効果を持つものであったとはいえない。

もっとも、前記(2)イにて認定したとおり、半導体装置製造に当たって表面実装方式が広く用いられるようになったことや、半導体装置の小型化に伴って樹脂内の気泡等に由来するボイドが不良品の主な原因を占めるようになったこと、また、金型壁面の加工技術の向上などから、本件発明が改めて注目され、平成4年ころから、ランナにおける樹脂に接する壁面を積極的に粗面状に加工したマルチポット方式の半導体樹脂封止金型として、本件発明が、他のボイド等の抑制技術と共に併用されるようになったことからみて、本件発明は、相応の技術的效果を有するものとして着目されていたと認められる。また、平成5年ころまでは、むしろ、ランナを鏡面加工することが主流であり（甲49の3）、本件発明が明らかに無効なものであると当業者に認識されていた形跡は認められず、本件発明には一応の他社に対する抑制的效果があったと推測される。

以上の点を総合すると、一審被告及び関連会社が製造した半導体装置は、他の歩留り向上のための技術や、他のボイド等の抑制技術と併用された本件発明の効果により、コスト削減に有意な影響を与え、これにより他社を排除するという若干の独占的效果を有していたといえ、一審被告が本件発明を自己実施することによって得た半導体装置の売上高に占める超過売上高の割合は、10%であると認めるのが相当である。

そうすると、一審被告が本件発明を自己実施することにより得た超過売上高は、本判決別表10の3（超過売上高）のとおり、1億3384万円（1万円未満切捨て）と認められる。

(ウ) 想定実施料

上記(イ)の事情のほか、本件に現れた諸事情を総合的に考慮すると、本件発明の想定実施料率は、２％であると認めるのが相当である。

そうすると、本件発明の想定実施料は、本判決別表１０の４（想定実施料）のとおり、２６７万６０００円（千円未満切捨て）と認められる。」

(7) 原判決３２頁６行目から同１５行目までを次のとおり改める。

「証拠（甲６，２１の１・２，２２，２８，３７）及び弁論の全趣旨によれば、①一審原告は、昭和６０年ころ、ＥＰＲＯＭ装置（紫外線消去型プログラムブル・リード・オンリ・メモリ装置）の樹脂封止工程において金属細線の変形や断線が多発したことから、その問題を解決するため、樹脂の注入経過を観察していたところ、樹脂の先端に気泡が発生していることを発見したこと、②Ａは、その当時、一審原告の上司であったが、一審原告に対して、樹脂に気泡が発生することをメルトフラクチャー現象という旨を教示したこと、③一審原告は、Ａに教示されたことを契機に、気泡の低減化技術の研究を継続し、本件発明を着想したこと、④本件発明当時、一審原告は、金型の開発等を所管とする実装技術部門実装技術開発課に所属していたことが認められる。

そうすると、一審原告は、一審被告から発明の課題を直接には提供されていないものの、着想の契機を提供され、担当業務の延長として、一審被告の研究施設や資機材を用いて本件発明に至ったものということができる。

以上の事情を総合的に考慮すると、本件発明がされるについて一審被告が貢献した程度は、７５％であると認めるのが相当である。

そうすると、本件発明の対価は、本判決別表１０の５（使用者貢献度）のとおり、６６万９０００円（千円未満切捨て）と認められる。」

(8) 原判決３３頁２行目から同１０行目までを次のとおり改める。

「４ 以上に認定の相当対価６６万９０００円から既払いの報奨金１６万３０

〇〇円（前記第2，1(3)イ）を控除すれば，未払の相当対価の額は，50万6000円となる。

- 5 よって，一審原告の請求は，相当対価50万6000円及びこれに対する本件訴状送達により催告のあった日の翌日である平成22年10月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，その余は理由がない。」

2 補充の判断

(1) 一審原告の主張について

第3，1(1)（売上高）については，上記1に認定判断のとおりであるから，その余の点について，以下，検討する。

ア 「自己実施割合」に対して

一審原告は，金型の寿命は3年程度が相当である旨を主張する。

しかしながら，本件証拠上，各個別の金型の実際の使用期間を直接に明らかにする証拠はなく，その耐用年数を平均的な使用可能回数から推認するほかないところ，これによれば，前記のとおり使用期間を5年とするのが相当というべきである。

一審原告の上記主張は，採用することができない。

イ 「技術的優位性」に対して

一審原告は，本件発明の技術的優位性はランナの断面形状を台形状に形成した点にもある旨を主張する。

しかしながら，本件特許の特許請求の範囲には，ランナの断面形状を台形状に形成した点は含まれないのであり，この点において一審被告に独占の利益は生じていない。

したがって，一審被告は，上記の点について本件発明から利益を受けるべき関係にはない。一審原告の上記主張は，採用することができない。

ウ 「訴訟手続違反」に対して

一審原告の主張は、①半導体製品の実売上高から算出した本件発明に係る半導体装置の売上高を、②実施貢献度から算出した本件発明の実施に係る半導体装置の売上高が上回るにもかかわらず、原判決はその旨について判断していないとする旨の主張と善解されるところ、②の売上高は、単に、一審被告が本件発明の実施貢献度を算定する際にした評価にすぎず、①の売上高よりも信頼性に勝るものではないから、その主張に係る前提事実を認めるに足る証拠はないというべきである（なお、原判決も、その旨の認定をしたのであって、一審原告の主張は、原判決を正解するものではない。）。

なお、相当対価の算定方法は、裁判所が裁量により決することであり、当事者が複数の算定方式を提示したとしても、それは当事者の意見にすぎないのであり、事実主張を構成するものではないから、裁判所が、ある算定方法のみに従って相当対価を算定したからといって、判断遺脱になる余地はないものと解される。一審原告の上記主張は、いずれにしても失当である。

(2) 一審被告の主張について

ア 「自己実施」に対して

一審被告は、マルチポット方式による半導体樹脂封止金型には、「ランナ部」が存在し得ない旨の主張をする。

しかしながら、本件発明にいうランナは、ポットからキャビティまでの間の長短を問わない樹脂を送るための流路をいうのであり、経路断面積が狭まる部分であるからといって本件発明の効果が排斥されとする証拠もないのであって、一審被告のいうところのマルチポット方式における「ゲート部」に含まれる流路も、本件発明の「ランナ」を含むものである。

一審被告の上記主張は、採用することができない。

イ 「公然実施」に対して

一審被告は、本件特許出願前後を通じて、一審被告の半導体装置の製造方法には変更がなかった旨を主張する。

しかしながら、本件特許出願前に作成されたマルチポット方式の金型の製作仕様書（乙１２の１～３）をみても、ランナ部が梨地になっていることは明らかでなく、また、本件特許出願後に作成されたマルチポット方式の金型のうち仕様書作成日が平成元年９月２５日となっているもの（甲１８の１・２）についても、金型製作仕様書だけからは、ランナ部が梨地になっていることは判明しない。しかしながら、本件特許出願後に作成されたマルチポット方式の金型のうち仕様書作成日が平成８年８月１４日以降となっているもの（甲１８の３～７）については、金型製作仕様書にランナ部を梨地とすることが明記されている。

したがって、本件特許出願前後を通じて一審被告の製造方法に変更がなかったとは認められず、本判決別表１のとおり、一審被告は、平成４年７月２日以降に至ってから、本件発明を実施しているものと認められる。

一審被告の上記主張は、採用することができない。

ウ 「売上高」に対して

一審被告は、金型に関する発明である本件発明から一審被告の受けた利益は、当該金型を使用して製造された半導体装置の売上高とは関連性を有しない旨の主張をする。

しかしながら、物（半導体装置）を生産する物（金型）の発明において、当該発明に係る物（金型）を用いて生産された物（半導体装置）を譲渡することは、当該発明の実施ではないが、職務発明の承継により使用者等が受けるべき利益は、発明の実施自体から得るべき利益に限定される理由はないのであり、発明の実施と直接的な関連性があれば足りると解すべきである。一審被告は、半導体装置を譲渡するために本件発明を実施したのであり、半導体装置を譲渡したことにより一審被告が得た利益の一部は、本件発明の本来的な目的・用途に従って通常生じるものであって、本件発明を実施することにより一審被告が得た利益というべきである。

一審被告の上記主張は、採用することができない。

第5 結論

よって、一審原告の控訴に基づいて、原判決を本判決主文第1項のとおりに変更することとし、一審被告の控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第2部

裁判長裁判官

清 水 節

裁判官

中 村 恭

裁判官

中 武 由 紀

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和60年特許願第282339号(特開昭62-140426号、昭和62年6月24日発行、公開特許公報62-140426号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。7(1)

Int. Cl.	識別記号	庁内整理番号
H01L 21/56		7-6412-57
B29C 45/03		2111-47
45/14		2111-47
45/26		6949-47
// B29C 33/42		8413-47
B29L 31/34		0000-47

平成 2. 4.-5 発行

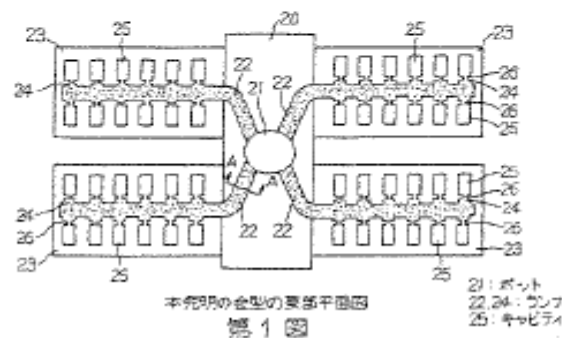
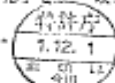
予 紀 補 正 書

平成元年11月30日

特許庁長官

殿

- 1 事件の表示
昭和60年 特 許 願 第282339号
- 2 発明の名称
断面封止金型
- 3 補正をする者
事件との関係 特許出願人
住 所
名 称 (029) 沖電気工業株式会社
代 表 者
- 4 代 理 人 (郵便番号 101)
5580 弁護士
- 5 補正命令の日付 自 発
- 6 補正の対象
明細書の「発明の詳細な説明」の欄、及び図面
- 7 補正の内容
(1) 明細書、3頁13行目の「敷化」を、「硬化」と補正する。
(2) 第1図を別紙の通り補正する。



(平成26年(ホ)第10040号事件判決別表1)

被控訴人及びその関連会社がTOWA株式会社に製作させた半導体樹脂封止金型一覧表

仕様書作成年月日	製造番号		金型名称	台数	光沢 累計	梨地 累計	流路壁面の 状態	証拠図面
	客先番号	製造番号						
昭和60年 1月17日	CO	1007	DIP14/16 56CAV	4	4	0	光沢	甲42の2, 乙12の1
昭和60年 5月13日	CO	2066	16LD IDF 112CAV	1	5	0	光沢	甲42の2
昭和60年 6月 3日	CO	1125	14/16LD DIP 56CAV	3	8	0	光沢	甲42の2, 乙12の2
	CO	1126	8LD DIP 112CAV	2	10	0	光沢	甲42の2, 乙12の3
昭和61年 5月20日	CO	1224	8LD DIP 112CAV	2	12	0	光沢	甲42の2
昭和61年 6月27日	CO	1235	18(L)/22pin PLCC 40CAV	2	14	0	光沢	甲42の2
昭和61年11月27日	CO	1353W・1354W	14/16LD DIP 56CAV	2	16	0	光沢	甲42の2
昭和61年12月	CO	1372	18PIN PLCC 40CAV	2	18	0	光沢	甲42の2
昭和62年 4月 6日	CO	1450	56p R-FLAT(GS-Kタイプ) 40CAV	1	19	0	光沢	甲42の2
昭和63年 5月17日	CO	1956W・1957W	18PIN PLCC 40CAV	2	21	0	光沢	甲42の2
昭和63年 8月22日	CO	1023	RDIP 18PIN 20CAV	1	22	0	光沢	甲42の2
昭和63年10月17日	CO	1994	RDIP 20PIN 20CAV	1	23	0	光沢	甲42の2
昭和63年11月24日	JC	1377W	18PIN PLCC 40CAV	1	24	0	光沢	甲42の2
昭和63年12月15日	CO	1324W	SOJ26PIN 350MIL 20CAV	1	25	0	光沢	甲42の2
昭和63年12月19日	CO	1325W・1326W	ZIP20PIN 20CAV	2	27	0	光沢	甲42の2
平成 元年 4月 7日	JC	1640W・1641W	26p SOJ 40CAV	2	29	0	光沢	甲42の2
平成 元年 6月22日	CO	1815	SOJ26PIN 350MIL 20CAV	1	30	0	光沢	甲39の1, 42の2
	CO	1869	RDIP20PIN 400MIL 16CAV	1	31	0	光沢	甲39の2, 42の2
平成 元年 8月17日	CO	1870	RDIP18PIN 400MIL 16CAV	1	32	0	光沢	甲39の3, 42の2
	II	1644	26PIN SOJ 20CAV	1	33	0	光沢	甲42の2, 56の1
平成 元年 9月 1日	CO	1937・1995	ZIP20PIN 400MIL 20CAV	2	35	0	光沢	甲42の2
平成 元年 9月25日	II	1037・1038	SOP28PIN 20CAV	1	36	0	光沢	甲18の1, 42の2
	II	1040・1041	ZIP28PIN 20CAV	2	38	0	光沢	甲18の2, 42の2
平成 元年12月15日	CO	1197	PLCC 68PIN	1	39	0	光沢	甲42の2
平成 2年 4月23日	CO	1419	FLAT44/56PIN 40CAV	1	40	0	光沢	甲42の2
平成 2年 5月25日	CO	1463	SOJ26PIN 40CAV	4	44	0	光沢	甲42の2
平成 2年 5月 1日	CO	1993	28PIN RDIP 24CAV	1	45	0	光沢	甲42の2
平成 2年12月10日	CO	11208・11209	TSOP32PIN 32CAV	2	47	0	光沢	甲42の2
	CO	11210	TSOP26PIN 20CAV	1	48	0	光沢	甲42の2
	CO	11212・11213	TSOP32PIN 32CAV	2	50	0	光沢	甲42の2
平成 4年 3月16日	CO	12562	光MOSリレー SOP6PIN 20CAV	1	51	0	光沢	甲42の2
平成 4年 7月 2日	CO	12863	QFP64/80PIN (t=2.1) 24CAV	2	51	2	梨地	甲42の2
	CO	12864	QFP64/80PIN (t=3.75) 24CAV	2	51	4	梨地	甲42の2
平成 4年 7月16日	CO	12862	ShrinkDIP42PIN 24CAV	2	53	4	光沢	甲42の2
平成 4年 7月23日	II	12976・12977	TSOP28/44PIN 20CAV	2	55	4	光沢	甲42の2
	II	12978・12979	TSOP32PIN 20CAV	2	57	4	光沢	甲42の2
平成 4年 8月27日	II	12984	SOJ26PIN 300MIL 20CAV	1	58	4	光沢	甲42の2, 56の2
平成 4年11月 4日	CO	21372	SC62 24CAV	1	59	4	光沢	甲42の2
平成 5年 3月23日	CO	21391	DIP18PIN 160CAV	1	60	4	光沢	甲42の2
平成 5年 7月15日	CO	21430	SC62 240CAV	1	61	4	光沢	甲42の2
平成 6年 3月10日	CO	14030・14031	TSOP48PIN 16CAV	2	63	4	光沢	甲42の2
	CO	14173	TSOP28/44PIN 20CAV	1	64	4	光沢	甲42の2
平成 6年 9月21日	II	14627	50TSOP 20CAV	1	65	4	光沢	甲42の2
平成 6年10月 3日	CO	14690	EC-SOP(SOP6PIN) 20CAV	1	65	5	梨地	甲42の2
平成 7年 1月21日	CO	14931	OCS52(SOP8PIN) 20CAV	1	65	6	梨地	甲42の2
平成 7年 5月17日	II	15287	70TSOP 20CAV	1	65	7	梨地	甲42の2
平成 7年 7月11日	II	15415	26TSOP(0.95t) 20CAV	1	65	8	梨地	甲42の2
平成 8年 8月14日	II	17981	26P SOJ(300)LOC 20CAV	1	65	9	梨地	甲18の3, 42の2
平成 8年10月11日	CO	17989	SO6 OCMD 一次モールド	1	65	10	梨地	甲42の2
平成 9年 5月23日	CO	19356	OPT OCM42E	1	65	11	梨地	甲42の2
平成10年 4月20日	CO	23815	光MOS 8PIN 20CAV	1	65	12	梨地	甲42の2
平成10年 6月24日	JC	24230	P-LBGA-144-1313-0.80 20CAV	1	65	13	梨地	甲18の4, 42の2
平成10年 7月10日	JC	24232	P-LFBGA-224-1515-0.80 20CAV	1	65	14	梨地	甲18の5, 42の2
平成10年11月20日	CO	25141	SOP4PIN 40CAV	1	65	15	梨地	甲42の2
平成11年 7月21日	CO	91001468	OCMS4260 20CAV	1	65	16	梨地	甲42の2
平成11年 8月10日	CO	91001380	Multi-BGA□6~12(MA) 8CAV	1	65	17	梨地	甲18の6, 42の2
平成12年 4月27日	ACO	91009263・4	LQFP176-P-2424(Cu) 24CAV	2	65	19	梨地	甲42の2, 53
平成13年 4月20日	ACO	91022118	P-TFBGA70-6.4×10(±0.5) 8CAV	1	65	20	梨地	甲18の7, 42の2
平成13年11月	AT	10055	DIP18P	1	65	21	梨地	甲42の2
平成14年 1月	AT	10056	TSOP44P(Normal)	1	65	22	梨地	甲42の2
平成14年 4月	AT	10057	LQFP144P	1	65	23	梨地	甲42の2
平成14年 5月	AT	10061	TSOP44P(Normal)	1	65	24	梨地	甲42の2
	AT	10062・10063	LQFP144P	2	65	26	梨地	甲42の2
平成14年12月	AT	10070	TSOP50P(LOC)	1	65	27	梨地	甲42の2
平成15年 3月	AT	10072	LQFP176-P-2424(CU)	1	65	28	梨地	甲42の2
平成16年 4月19日	AJC	91039874	P-TFBGA208-1212 4CAV	1	65	29	梨地	甲42の2
				合計	94			

(平成26年(ホ)第10040号事件判決別表2)

被控訴人及びその関連会社がTOWA株式会社に製作させた半導体樹脂封止金型一覧表

仕様書作成年月日	製造番号		金型名称	台数	光沢 累計	梨地 累計	流路壁面の 状態	証拠図面
	客先番号	受注番号						
昭和63年 5月17日	CO	1956W・1957W	18PIN PLCC 40CAV	2	2	0	光沢	甲42の2
昭和63年 8月22日	CO	1023	RDIP 18PIN 20CAV	1	3	0	光沢	甲42の2
昭和63年10月17日	CO	1994	RDIP 20PIN 20CAV	1	4	0	光沢	甲42の2
昭和63年11月24日	JC	1377W	18PIN PLCC 40CAV	1	5	0	光沢	甲42の2
昭和63年12月15日	CO	1324W	SOJ26PIN 300MIL 20CAV	1	6	0	光沢	甲42の2
昭和63年12月19日	CO	1325W・1326W	ZIP20PIN 20CAV	2	8	0	光沢	甲42の2
平成 元年 4月 7日	JC	1640W・1641W	26p SOJ 40CAV	2	10	0	光沢	甲42の2
平成 元年 6月19日	CO	1815	SOJ26PIN 350MIL 20CAV	1	11	0	光沢	甲39の1, 42の2
平成 元年 6月22日	CO	1869	RDIP20PIN 400MIL 16CAV	1	12	0	光沢	甲39の2, 42の2
	CO	1870	RDIP18PIN 400MIL 16CAV	1	13	0	光沢	甲39の3, 42の2
平成 元年 8月17日	II	1644	26PIN SOJ 20CAV	1	14	0	光沢	甲42の2, 56の1
平成 元年 9月 1日	CO	1937・1995	ZIP20PIN 400MIL 20CAV	2	16	0	光沢	甲42の2
平成 元年 9月25日	II	1037・1038	SOP28PIN 20CAV	1	17	0	光沢	甲18の1, 42の2
	II	1040・1041	ZIP28PIN 20CAV	2	19	0	光沢	甲18の2, 42の2
平成 元年12月15日	CO	1197	PLCC 68PIN	1	20	0	光沢	甲42の2
平成 2年 4月23日	CO	1419	FLAT44/56PIN 40CAV	1	21	0	光沢	甲42の2
平成 2年 5月25日	CO	1463	SOJ26PIN 40CAV	4	25	0	光沢	甲42の2
平成 2年 5月 1日	CO	1993	28PIN RDIP 24CAV	1	26	0	光沢	甲42の2
平成 2年12月10日	CO	11208・11209	TSOP32PIN 32CAV	2	28	0	光沢	甲42の2
	CO	11210	TSOP26PIN 20CAV	1	29	0	光沢	甲42の2
	CO	11212・11213	TSOP32PIN 32CAV	2	31	0	光沢	甲42の2
平成 4年 3月16日	CO	12562	光MOSリレー SOP6PIN 20CAV	1	32	0	光沢	甲42の2
平成 4年 7月 2日	CO	12863	QFP64/80PIN (t=2.1) 24CAV	2	32	2	梨地	甲42の2
	CO	12864	QFP64/80PIN (t=3.75) 24CAV	2	32	4	梨地	甲42の2
平成 4年 7月16日	CO	12862	ShrinkDIP42PIN 24CAV	2	34	4	光沢	甲42の2
平成 4年 7月23日	II	12976・12977	TSOP28/44PIN 20CAV	2	36	4	光沢	甲42の2
	II	12978・12979	TSOP32PIN 20CAV	2	38	4	光沢	甲42の2
平成 4年 8月27日	II	12984	SOJ26PIN 300MIL 20CAV	1	39	4	光沢	甲42の2, 56の2
平成 4年11月 4日	CO	21372	SC62 24CAV	1	40	4	光沢	甲42の2
平成 5年 3月23日	CO	21391	DIP18PIN 160CAV	1	41	4	光沢	甲42の2
				合計	45			

(平成26年(ホ)第10040号事件判決別表3)

被控訴人及びその関連会社がTOWA株式会社に製作させた半導体樹脂封止金型一覧表

仕様書作成年月日	製造番号		金型名称	台数	光沢 累計	梨地 累計	流路壁面の 状態	証拠図面
	客先番号	受注番号						
平成 元年 4月 7日	JC	1640W・1641W	26p SOJ 40CAV	2	2	0	光沢	甲42の2
平成 元年 6月19日	CO	1815	SOJ26PIN 350MIL 20CAV	1	3	0	光沢	甲39の1, 42の2
平成 元年 6月22日	CO	1869	RDIP20PIN 400MIL 16CAV	1	4	0	光沢	甲39の2, 42の2
	CO	1870	RDIP18PIN 400MIL 16CAV	1	5	0	光沢	甲39の3, 42の2
平成 元年 8月17日	JJ	1644	26PIN SOJ 20CAV	1	6	0	光沢	甲42の2, 56の1
平成 元年 9月 1日	CO	1937・1995	ZIP20PIN 400MIL 20CAV	2	8	0	光沢	甲42の2
平成 元年 9月25日	JJ	1037・1038	SOP28PIN 20CAV	1	9	0	光沢	甲18の1, 42の2
	JJ	1040・1041	ZIP28PIN 20CAV	2	11	0	光沢	甲18の2, 42の2
平成 元年12月15日	CO	1197	PLCC 68PIN	1	12	0	光沢	甲42の2
平成 2年 4月23日	CO	1419	FLAT44/56PIN 40CAV	1	13	0	光沢	甲42の2
平成 2年 5月25日	CO	1463	SOJ26PIN 40CAV	4	17	0	光沢	甲42の2
平成 2年 5月 1日	CO	1993	28PIN RDIP 24CAV	1	18	0	光沢	甲42の2
平成 2年12月10日	CO	11208・11209	TSOP32PIN 32CAV	2	20	0	光沢	甲42の2
	CO	11210	TSOP26PIN 20CAV	1	21	0	光沢	甲42の2
	CO	11212・11213	TSOP32PIN 32CAV	2	23	0	光沢	甲42の2
	CO	12562	光MOSリレー SOP6PIN 20CAV	1	24	0	光沢	甲42の2
平成 4年 3月16日	CO	12562	光MOSリレー SOP6PIN 20CAV	1	24	0	光沢	甲42の2
平成 4年 7月 2日	CO	12863	QFP64/80PIN (t=2.1) 24CAV	2	24	2	梨地	甲42の2
	CO	12864	QFP64/80PIN (t=3.75) 24CAV	2	24	4	梨地	甲42の2
平成 4年 7月16日	CO	12862	ShrinkDIP42PIN 24CAV	2	26	4	光沢	甲42の2
平成 4年 7月23日	JJ	12976・12977	TSOP28/44PIN 20CAV	2	28	4	光沢	甲42の2
	JJ	12978・12979	TSOP32PIN 20CAV	2	30	4	光沢	甲42の2
平成 4年 8月27日	JJ	12984	SOJ26PIN 300MIL 20CAV	1	31	4	光沢	甲42の2, 56の2
平成 4年11月 4日	CO	21372	SC62 24CAV	1	32	4	光沢	甲42の2
平成 5年 3月23日	CO	21391	DIP18PIN 160CAV	1	33	4	光沢	甲42の2
平成 5年 7月15日	CO	21430	SC62 240CAV	1	34	4	光沢	甲42の2
平成 6年 3月10日	CO	14030・14031	TSOP48PIN 16CAV	2	36	4	光沢	甲42の2
	CO	14173	TSOP28/44PIN 20CAV	1	37	4	光沢	甲42の2

合計 41

(平成26年(ホ)第10040号事件判決別表4)

被控訴人及びその関連会社がTOWA株式会社に製作させた半導体樹脂封止金型一覧表

仕様書作成年月日	製造番号		金型名称	台数	光沢 累計	梨地 累計	流路壁面の 状態	証拠図面
	客先番号	受注番号						
平成 2年 4月23日	CO	1419	FLAT44/56PIN 40CAV	1	1	0	光沢	甲42の2
平成 2年 5月25日	CO	1463	SOI26PIN 40CAV	4	5	0	光沢	甲42の2
平成 2年 5月 1日	CO	1993	28PIN RDIP 24CAV	1	6	0	光沢	甲42の2
平成 2年12月10日	CO	11208・11209	TSOP32PIN 32CAV	2	8	0	光沢	甲42の2
	CO	11210	TSOP26PIN 20CAV	1	9	0	光沢	甲42の2
	CO	11212・11213	TSOP32PIN 32CAV	2	11	0	光沢	甲42の2
平成 4年 3月16日	CO	12562	光MOSリレー SOP6PIN 20CAV	1	12	0	光沢	甲42の2
平成 4年 7月 2日	CO	12863	QFP64/80PIN (t=2.1) 24CAV	2	12	2	梨地	甲42の2
	CO	12864	QFP64/80PIN (t=3.75) 24CAV	2	12	4	梨地	甲42の2
平成 4年 7月16日	CO	12862	ShrinkDIP42PIN 24CAV	2	14	4	光沢	甲42の2
平成 4年 7月23日	II	12976・12977	TSOP28/44PIN 20CAV	2	16	4	光沢	甲42の2
	II	12978・12979	TSOP32PIN 20CAV	2	18	4	光沢	甲42の2
平成 4年 8月27日	II	12984	SOI26PIN 300MIL 20CAV	1	19	4	光沢	甲42の2、56の2
平成 4年11月 4日	CO	21372	SC62 24CAV	1	20	4	光沢	甲42の2
平成 5年 3月23日	CO	21391	DIP18PIN 160CAV	1	21	4	光沢	甲42の2
平成 5年 7月15日	CO	21430	SC62 240CAV	1	22	4	光沢	甲42の2
平成 6年 3月10日	CO	14030・14031	TSOP48PIN 16CAV	2	24	4	光沢	甲42の2
	CO	14173	TSOP28/44PIN 20CAV	1	25	4	光沢	甲42の2
平成 6年 9月21日	II	14627	50TSOP 20CAV	1	26	4	光沢	甲42の2
平成 6年10月 3日	CO	14690	EC-SOP(SOP6PIN) 20CAV	1	26	5	梨地	甲42の2
平成 7年 1月21日	CO	14931	OCS52(SOP8PIN) 20CAV	1	26	6	梨地	甲42の2
				合計	32			

(平成26年(ネ)第10040号事件判決別表5)

被控訴人及びその関連会社がTOWA株式会社に製作させた半導体樹脂封止金型一覧表

仕様書作成年月日	製造番号		金型名称	台数	光沢 累計	製地 累計	流路壁面の 状態	証拠図面
	客先番号	受注番号						
平成 4年 3月16日	CO	12562	光MOSリレー SOP6PIN 20CAV	1	1	0	光沢	甲42の2
平成 4年 7月 2日	CO	12863	QFP64/80PIN (t=2.1) 24CAV	2	1	2	梨地	甲42の2
	CO	12864	QFP64/80PIN (t=3.75) 24CAV	2	1	4	梨地	甲42の2
平成 4年 7月16日	CO	12862	ShrinkDIP42PIN 24CAV	2	3	4	光沢	甲42の2
平成 4年 7月23日	II	12976・12977	TSOP28/44PIN 20CAV	2	5	4	光沢	甲42の2
	II	12978・12979	TSOP32PIN 20CAV	2	7	4	光沢	甲42の2
平成 4年 8月27日	II	12984	SOJ26PIN 300MIL 20CAV	1	8	4	光沢	甲42の2, 56の2
平成 4年11月 4日	CO	21372	SC62 24CAV	1	9	4	光沢	甲42の2
平成 5年 3月23日	CO	21391	DIP18PIN 160CAV	1	10	4	光沢	甲42の2
平成 5年 7月15日	CO	21430	SC62 240CAV	1	11	4	光沢	甲42の2
平成 6年 3月10日	CO	14030・14031	TSOP48PIN 16CAV	2	13	4	光沢	甲42の2
	CO	14173	TSOP28/44PIN 20CAV	1	14	4	光沢	甲42の2
平成 6年 9月21日	II	14627	50TSOP 20CAV	1	15	4	光沢	甲42の2
平成 6年10月 3日	CO	14690	EC-SOP(SOP6PIN) 20CAV	1	15	5	梨地	甲42の2
平成 7年 1月21日	CO	14931	OCS52(SOP8PIN) 20CAV	1	15	6	梨地	甲42の2
平成 7年 5月17日	II	15287	70TSOP 20CAV	1	15	7	梨地	甲42の2
平成 7年 7月11日	II	15415	26TSOP(0.95t) 20CAV	1	15	8	梨地	甲42の2
				合計	23			

(平成26年(ホ)第10040号事件判決別表6)

被控訴人及びその関連会社がTOWA株式会社に製作させた半導体樹脂封止金型一覧表

仕様書作成年月日	製造番号		金型名称	台数	光沢 累計	製地 累計	流路壁面の 状態	証拠図面
	客先番号	受注番号						
平成 4年 7月 2日	CO	12863	QFP64/80PIN (t=2.1) 24CAV	2	0	2	梨地	甲42の2
	CO	12864	QFP64/80PIN (t=3.75) 24CAV	2	0	4	梨地	甲42の2
平成 4年 7月16日	CO	12862	ShrinkDIP42PIN 24CAV	2	2	4	光沢	甲42の2
平成 4年 7月23日	JJ	12976・12977	TSOP28/44PIN 20CAV	2	4	4	光沢	甲42の2
	JJ	12978・12979	TSOP32PIN 20CAV	2	6	4	光沢	甲42の2
平成 4年 8月27日	JJ	12984	SOJ26PIN 300MIL 20CAV	1	7	4	光沢	甲42の2, 56の2
平成 4年11月 4日	CO	21372	SC62 24CAV	1	8	4	光沢	甲42の2
平成 5年 3月23日	CO	21391	DIP18PIN 160CAV	1	9	4	光沢	甲42の2
平成 5年 7月15日	CO	21430	SC62 240CAV	1	10	4	光沢	甲42の2
平成 6年 3月10日	CO	14030・14031	TSOP48PIN 16CAV	2	12	4	光沢	甲42の2
	CO	14173	TSOP28/44PIN 20CAV	1	13	4	光沢	甲42の2
平成 6年 9月21日	JJ	14627	50TSOP 20CAV	1	14	4	光沢	甲42の2
平成 6年10月 3日	CO	14690	EC-SOP(SOP6PIN) 20CAV	1	14	5	梨地	甲42の2
平成 7年 1月21日	CO	14931	OCS52(SOP8PIN) 20CAV	1	14	6	梨地	甲42の2
平成 7年 5月17日	JJ	15287	70TSOP 20CAV	1	14	7	梨地	甲42の2
平成 7年 7月11日	JJ	15415	26TSOP(0.95t) 20CAV	1	14	8	梨地	甲42の2
平成 8年 8月14日	JJ	17981	26P SOJ(300)LOC 20CAV	1	14	9	梨地	甲18の3, 42の2
平成 8年10月11日	CO	17989	SO6 OCMD 一次モールド	1	14	10	梨地	甲42の2
				合計	24			

(平成26年(ネ)第10040号事件判決別表7)

被控訴人及びその関連会社がTOWA株式会社に製作させた半導体樹脂封止金型一覧表

仕様書作成年月日	製造番号		金型名称	台数	光沢 累計	梨地 累計	流路壁面の 状態	証拠図面
	客先番号	受注番号						
平成 5年 7月15日	CO	21430	SC62 240CAV	1	1	0	光沢	甲42の2
平成 6年 3月10日	CO	14030・14031	TSOP48PIN 16CAV	2	3	0	光沢	甲42の2
	CO	14173	TSOP28/44PIN 20CAV	1	4	0	光沢	甲42の2
平成 6年 9月21日	JJ	14627	50TSOP 20CAV	1	5	0	光沢	甲42の2
平成 6年10月 3日	CO	14690	EC-SOP(SOP6PIN) 20CAV	1	5	1	梨地	甲42の2
平成 7年 1月21日	CO	14931	OCS52(SOP8PIN) 20CAV	1	5	2	梨地	甲42の2
平成 7年 5月17日	JJ	15287	70TSOP 20CAV	1	5	3	梨地	甲42の2
平成 7年 7月11日	JJ	15415	26TSOP(0.95t) 20CAV	1	5	4	梨地	甲42の2
平成 8年 8月14日	JJ	17981	26P SOJ(300)LOC 20CAV	1	5	5	梨地	甲18の3, 42の2
平成 8年10月11日	CO	17989	SO6 OCMD 一次モールド	1	5	6	梨地	甲42の2
平成 9年 5月23日	CO	19356	OPT OCM42E	1	5	7	梨地	甲42の2

合計 12

(平成26年(ネ)第10040号事件判決別表8)

被控訴人及びその関連会社がTOWA株式会社に製作させた半導体樹脂封止金型一覧表

仕様書作成年月日	製造番号		金型名称	台数	光沢 累計	梨地 累計	流路壁面の 状態	証拠図面
	客先番号	受注番号						
平成 6年 9月21日	II	14627	50TSOP 20CAV	1	1	0	光沢	甲42の2
平成 6年10月 3日	CO	14690	EC-SOP(SOP6PIN) 20CAV	1	1	1	梨地	甲42の2
平成 7年 1月21日	CO	14931	OCS52(SOP8PIN) 20CAV	1	1	2	梨地	甲42の2
平成 7年 5月17日	II	15287	70TSOP 20CAV	1	1	3	梨地	甲42の2
平成 7年 7月11日	II	15415	26TSOP(0.95t) 20CAV	1	1	4	梨地	甲42の2
平成 8年 8月14日	II	17981	26P SOJ(300)LOC 20CAV	1	1	5	梨地	甲18の3, 42の2
平成 8年10月11日	CO	17989	SO6 OCMD 一次モールド	1	1	6	梨地	甲42の2
平成 9年 5月23日	CO	19356	OPT OCM42E	1	1	7	梨地	甲42の2
平成10年 4月20日	CO	23815	光MOS 8PIN 20CAV	1	1	8	梨地	甲42の2
平成10年 6月24日	JC	24230	P-LBGA-144-1313-0.80 20CAV	1	1	9	梨地	甲18の4, 42の2
平成10年 7月10日	JC	24232	P-LFBGA-224-1515-0.80 20CAV	1	1	10	梨地	甲18の5, 42の2
平成10年11月20日	CO	25141	SOP4PIN 40CAV	1	1	11	梨地	甲42の2
				合計	12			

(平成26年(ネ)第10040号事件判決別表9)

被控訴人及びその関連会社がTOWA株式会社に製作させた半導体樹脂封止金型一覧表

仕様書作成年月日	製造番号		金型名称	台数	光沢 累計	梨地 累計	流路壁面の 状態	証拠図面
	客先番号	受注番号						
平成 7年 5月17日	JJ	15287	70TSOP 20CAV	1	0	1	梨地	甲42の2
平成 7年 7月11日	JJ	15415	26TSOP(0.95t) 20CAV	1	0	2	梨地	甲42の2
平成 8年 8月14日	JJ	17981	26P SOJ(300)LOC 20CAV	1	0	3	梨地	甲18の3, 42の2
平成 8年10月11日	CO	17989	SO6 OCMD 一次モールド	1	0	4	梨地	甲42の2
平成 9年 5月23日	CO	19356	OPT OCM42E	1	0	5	梨地	甲42の2
平成10年 4月20日	CO	23815	光MOS 8PIN 20CAV	1	0	6	梨地	甲42の2
平成10年 6月24日	JC	24230	P-LBGA-144-1313-0.80 20CAV	1	0	7	梨地	甲18の4, 42の2
平成10年 7月10日	JC	24232	P-LFBGA-224-1515-0.80 20CAV	1	0	8	梨地	甲18の5, 42の2
平成10年11月20日	CO	25141	SOP4PIN 40CAV	1	0	9	梨地	甲42の2
平成11年 7月21日	CO	91001468	OCMS4260 20CAV	1	0	10	梨地	甲42の2
平成11年 8月10日	CO	91001380	Multi-BGA□6~12(MA) 8CAV	1	0	11	梨地	甲18の6, 42の2
				合計	11			

職務発明対価算定表

1. 関連売上高

年度	売上高	日割	梨地金型の割合	関連売上高	備考
4	¥150,870,000,000	213/365	4/45	¥7,825,950,000	
5	¥172,394,000,000	1	4/41	¥16,818,920,000	
6	¥187,311,000,000	1	6/32	¥35,120,810,000	
7	¥214,126,000,000	1	8/23	¥74,478,600,000	
8	¥131,338,000,000	1	10/24	¥54,724,160,000	
9	¥135,024,000,000	1	7/12	¥78,764,000,000	
10	¥116,741,000,000	1	11/12	¥107,012,580,000	
11	¥159,178,000,000	1	1	¥159,178,000,000	
12	¥181,900,000,000	1	1	¥181,900,000,000	
13	¥113,600,000,000	1	1	¥113,600,000,000	
14	¥119,200,000,000	1	1	¥119,200,000,000	
15	¥132,200,000,000	1	1	¥132,200,000,000	
16	¥150,700,000,000	1	1	¥150,700,000,000	
17	¥150,700,000,000	259/365	1	¥106,935,060,000	
	(合計)			¥1,338,458,080,000	

2. 発明の寄与度

	関連売上高	超過割合		発明の寄与度	備考
	¥1,338,458,080,000	0.001		1,338,450,000	

3. 超過売上高

	発明の寄与度	寄与割合		超過売上高	備考
	1,338,450,000	0.1		133,840,000	

4. 想定実施料

	超過売上高	実施料率		想定実施料	備考
	133,840,000	0.02		2,676,000	

5. 使用者貢献度

	想定実施料	使用者貢献度		発明対価	備考
	2,676,000	0.75		669,000	

6. 共同発明者間の寄与割合

	発明対価	寄与割合		相当対価	備考
	669,000	1		669,000	